

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年7月19日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	金信基金 张景鹏、泉果基金 李学涛、光大证券 孙啸、浙商证券 褚旭、智牛基金 林嘉豪、长城证券 周安琪、瑞银资管 王海明、申万宏源 陈俊兆、乐盈投资 李诗睿、华能信托 黄凯立、招银理财 周迪、华能信托 林志霆、Morgan Stanley 刘端、旭鑫资管 李凌飞、中金基金 汪洋、竣弘投资 陈翔、甬兴证券 陈宇哲、盛世景 张佳林、迁云投资 何恒、莞民投集团 黄靖霖、莞民投集团 王宇彪、平安证券 郭冠君、金元证券 张茜、国信证券 余方升、朗华集团 彭治国、兴融控股 黄楚鸿
会议时间	2024年7月19日 13:00-16:00
会议地点	佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 黄炎烽 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次现场调研主要分为现场参观及交流问答环节。</p> <p>一、参观情况 本次线下调研投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。</p> <p>二、交流环节：</p> <p>Q1. 公司在智能穿戴领域目前已进入哪些客户？有哪些产品可适用于穿戴设备？这些产品有哪些优势？ A1: 在智能穿戴领域，公司产品已进入 Google、小米、Meta、小天才等国际知名智能穿戴厂商；公司的 ePOP、eMCP 系列产品可应用于智能穿戴领域。凭借存储介质特性研究、自研固件算法、多芯片异构集成封装工艺及自研芯片测试设备与测试算法等核心技术优势，公司 ePOP、eMCP 产品具备小尺寸、低功耗、高可靠、高性能等优势。</p> <p>Q2. 能否介绍一下惠州佰维生产制造基地？公司自主封测制造能力有什么优势？ A2: 惠州佰维拥有芯片封测和模组制造两个生产模块，其中芯片封测生产模块进行从晶圆到芯片的封装测试工序，主要用于嵌入式存储产品的制造，并为模组制造生产模块提供 NAND Flash 芯片原料；模组制造生产模块主要进行 SMT、外壳组装及成品测试等工序，主要用于固态硬盘、内存条、存储卡等消费级/工业级存储产品的制造。在产品交付过程中，面对客户的大批量交付、急单交付</p>

	<p>等需求，公司自主封测制造能力可以确保客户交期与产品品质。</p> <p>Q3. 惠州佰维目前的技术能力和产能利用率水平如何？ A3: 惠州佰维专精于存储器封测及 SiP 封测，封装工艺国内领先，目前掌握 16 层叠 Die、30~40 μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平。目前产能利用率处于较高水平，公司正加紧惠州封测制造中心的产能扩建，以满足客户的交付需求。</p> <p>Q4. 公司对于存储板块三四季度的价格及景气度有什么展望？ A4: 三季度国内需求有所回落，但受北美 AI 服务器需求迅猛增长的影响，整体价格仍有支撑，当前国内供需关系较为焦灼，但从中期来看行业景气度有望延续。</p> <p>Q5. 公司“晶圆级先进封测”项目的技术团队组建情况？目前项目有什么规划？ A5: 公司已构建完整的、国际化的建制专业晶圆级先进封装技术、运营团队。目前，该项目已经进入实施阶段，正在进行设备采购和厂房建设准备等工作。该项目第一阶段满产后预计月产能为 1-2 万片 12 寸晶圆，后续将根据情况进行扩产。</p> <p>Q6. 业绩预告显示，公司今年上半年取得了非常不错的成绩，请问公司业绩同比大幅提升的原因是什么？ A6: 公司业绩较去年同比提升，主要系行业复苏，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。具体的经营情况请关注公司即将披露的《2024 年半年度报告》。</p> <p>Q7. 智能汽车市场潜力大，公司如何看待汽车智能化对存储需求的变化？公司在智能汽车领域有什么布局？ A7: 根据 Gartner 数据，预计至 2024 年，全球 ADAS 领域的 NAND Flash 存储消费将达到 41.5 亿 GB，2019 年-2024 年复合增速将达 79.9%。随着汽车智能化程度的不断加深，对存储芯片及模组的需求不断增加，给半导体存储器厂商带来新的市场机遇。公司于 2018 年获得 IATF16949:2016 汽车质量管理体系认证，2023 年公司先进封测制造中心——惠州佰维亦顺利通过 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证。公司已推出适用于智能汽车的 eMMC、UFS 和 LPDDR 等车规级存储芯片产品，并通过严苛的 AEC-Q100 车规可靠性验证，正在进行市场推广。</p> <p>Q8. 能否介绍一下公司定增项目的情况和最新进展？ A8: 公司拟向特定对象募集资金总额不超过 19 亿元用于“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”和“晶圆级先进封测制造项目”。此次募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司战略发展规划，有利于提高公司技术水平和核心竞争力，一方面将扩大公司产能，优化产品结构；另一方面将增强公司先进封测服务能力，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。目前定增正在稳步推进中，具体进展请关注公司后续披露的相关公告。</p>
--	---

	<p>Q9. 公司在研发方面持续保持高强度投入，目前在前沿技术方面有哪些布局？</p> <p>A9: 公司持续强化研发封测一体化布局，涉及存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节。公司拟定增资建设的晶圆级先进封测项目，涵盖 WLCSP、2.5D/3D 等晶圆级先进封装技术。同时，公司将积极探索新接口、新介质、存算一体、先进测试设备等创新领域。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 7 月 19 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。